論 文

MEMS マイクロミラーアレイを用いた静電気分布測定

正 員	栗山	敏秀* ^{a)}	非会員	高辻	渉**	正 員	伊東	隆喜**
非会員	前田	裕司**	非会員	中家	利幸***	非会員	松井	順***
			非会員	宮本	佳明***			

Electrostatic Field Distribution Measurement Using MEMS Micro-mirror Array

Toshihide Kuriyama^{*a)}, Member, Wataru Takatsuji^{**}, Non-member, Takaki Itoh^{**}, Member, Hiroshi Maeda^{**}, Non-member, Toshiyuki Nakaie^{***}, Non-member, Jun Matsui^{***}, Non-member, Yoshiaki Miyamoto^{***}, Non-member

(2013年10月12日受付, 2014年5月31日再受付)

Electrostatic field distribution measurement using a silicon micro-mirror array fabricated by Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) process has been presented. The deflection angle of each micro-mirror, which is placed on a spherical surface and is deflected by electrostatic field, was measured optically using a two-dimensional optical scanner and a position sensitive detector (PSD). The obtained electrostatic data showed good agreement with Coulomb's law and the system was applied to measure the electrostatic field distribution of charged substance.

キーワード:静電気分布, MEMS マイクロミラーアレイ, 2 次元光学スキャナー, Position sensitive detector **Keywords**: Electrostatic field, MEMS Micro-mirror array, Two-dimensional optical scanner, Position sensitive detector

1. まえがき

社会システムの安全・安心において、電子機器の誤作動 は大きな課題である。誤作動を引き起こす原因の一つとし て静電気放電(Electrostatic Discharge: ESD)があり、これは 大規模集積回路(LSI)が高集積化や低電圧化のため、静電 気放電に対する耐性が低くなっていることがある。また、 液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display: LCD)が製造時の 帯電によって故障を起こすという事も報告されている。静 電気放電による破壊を防ぐ方法の一つは、帯電物体を除電 することであり、そのためにも帯電物体による静電気分布 を測定することは重要である。従来、帯電電圧測定やその 分布測定は、表面電位計やそれを対象物上で機械的に2次

a) Correspondence to: Toshihide Kuriyama. E-mail: kuriyama@waka. kindai.ac.jp
* 近畿大学
〒649-6493 和歌山県紀の川市西三谷 930 Kinki University
930, Nishimitani, Kinokawa, Wakayama 649-6493, Japan
** 和歌山県工業技術センター
〒649-6261 和歌山市小倉 60 Industrial Technology Center of Wakayama Prefecture
60, Ogura, Wakayama 649-6261, Japan
*** 阪和電子工業(株)
〒649-6261 和歌山市大垣内 689-3 Hanwa Electronic Ind. Co., Ltd.
689-3, Ogaito, Wakayama 649-6261, Japan 元走査することにより行われてきた⁽¹⁾が,機械的な走査は 時間がかかり,その間に帯電状況が変化するという問題が あった。本研究では,静電気分布を非接触で短時間に測定 することを目的として,半導体微細加工技術により作製し たマイクロミラー(MEMS マイクロミラー)を用いて非接 触静電気分布測定システムを製作し,実際に適用した結果 について述べる。特に,100mm 角以上の広い面積の静電気 分布を測定するのに適した MEMS マイクロミラーアレイの 構成と測定のための光学系について報告する。

2. 静電気分布測定装置

〈2·1〉 マイクロミラーと静電気分布測定用光学系

帯電物体の静電気分布を測定する方法として, MEMS 技 術を用いて製作した 2 本のトーション・バー(捻り梁)で 支持されたマイクロミラー(トーション・ミラーと略す) をアレイ状に配置し,マイクロミラーの半面をシールド板 で覆うことにより残りの半面に電界が印加されるように し,静電気によるトーション・ミラーの捻れ角から静電気 分布を測定する方法を採用した。筆者らは,以前,複数の トーション・ミラーの角度変化を測定するために,レーザ 光を 2 次元光スキャナーにより走査し,それぞれのマイク ロミラーからのレーザ光の反射角を測定した⁽²⁾。この時, 凸レンズと 2 次元光スキャナーの距離を凸レンズの焦点距

^{© 2014} The Institute of Electrical Engineers of Japan.

離に等しく配置することにより,走査されたレーザ光はマ イクロミラーに垂直(電界が0の場合)に入射し,反射光 ビームはビームスプリッタを介して PSD (Position Sensitive Detector)上に入射し,ビームスポット位置からトーション・ ミラーの捻れ角が求められた。この光学系は、トーション・ ミラーアレイが作製されたシリコンウェーハをウェーハ状 態で使用でき、トーション・ミラーのサイズを小さくする ことにより,空間分解能をあげることができるという利点 があったが、逆に100mm角以上の面積に対し静電気分布を 測定する場合,大きな口径の凸レンズや大面積のシリコン ウェーハが必要となり,装置の価格や重量の増加が問題に なった。

そのため、今回は大面積の測定に適した凸レンズを使用しない光学系を採用した。Fig.1に凸レンズを使用した測定 光学系(a)と今回の光学系(b)の原理図を比較して示す。

Fig. 1(b)の配置では、トーション・ミラーは球面上にア レイ状に並べられており、レーザ光がマイクロミラーの裏 面に垂直に入射し、静電気により傾いたマイクロミラーの 傾きは反射光の PSD 上の位置により測定される。

両方の光学系において、トーション・ミラーが静電気に より角度φ傾いていれば、反射光の光軸に対する傾きθは

 $\theta = 2\varphi$ (1)

となる。傾き角度 θ の反射光は, PSD の位置で焦点を結び, その中心からの位置(変位)dは,

 $d = f \tan \theta$ (2)

となる。ここで、fはPSDと凸レンズとの距離、あるいは、

Torsion

PSD Lens mirror 8 Optical scanner 8 Beam splitter Laser Shield plate (a) with lens Torsion mirror PSD Optical scanner gł Beam Shield splitter plate Laser (b) without lens

Fig. 1. Optics for electrostatic field measurement

PSD と球面との光学的距離である。(2)式の関係は、2次元 スキャナーで走査されるすべての光ビームに対して成立す るため、トーション・ミラーアレイのそれぞれのマイクロ ミラーの傾きを2次元 PSD 上の光スポット位置 d により測 定することができる。

静電気分測定装置の性能仕様として、帯電物質の測定電 圧範囲:100~2kV,測定分解能:10V,測定距離:10mm, 測定範囲:100mm角,測定時間:1秒以下を目標とした。 この光学的な配置により、凸レンズを用いた配置⁽²⁾に比べ LCD(液晶ディスプレイ)のような広い面積も測定するこ とが可能になる。

〈2·2〉 トーション・ミラーの構造および製造方法

トーション・ミラーの実装に関しては、Fig.1(a)の光学で は、ウェーハ状態のトーション・ミラーアレイを用いるこ とができるのに対し、Fig.1(b)の光学系では、トーション・ ミラーを分離して球面上に搭載する必要があるため、同じ 空間分解能を得るためにはマイクロミラーの面積を保って トーション・ミラー全体の面積を小さくする必要があり、 Fig.2に示したようにマイクロミラーを蝶々型にしてトー ション・バーを一定の長さに保つ構造にした。

この時,製造時におけるトーション部分の破損を防ぐため, Fig.2に示すように,複数の補強用梁をトーション・バーと並べて設け強度を増した。

トーション・ミラーは SOI (Silicon on Insulator) ウェーハ を用い, Fig. 3 に示す工程で製造された。

Fig. 3 において,フォトレジストをエッチングマスクに



Fig. 2. Torsion-mirror with support beam



用い表面の SiO₂ とシリコン層をドライエッチングした (Fig. 3(a))。その後, 裏面から SiO₂をマスクに用い TMAH (Tetramethylammonium hydroxide) によりトーション・ミラー の下部にある基板 Si をエッチングにより除去した (Fig. 3 (b))。最後に表面, 側面と裏面の SiO₂をフッ化水素酸溶液 により除去し, 裏面に熱剥離シートを貼った後, ステルス ダイシングを行った (Fig. 3(c))。

この構造および製造方法により,厚さ20µm,幅10µmのトーション・ミラーで歩留まりが約80%から約100%へ,厚さ20µm,幅5µmのトーション・ミラーで歩留まりが約14%から約82%に改善された。

ウェーハから分離されたトーション・ミラーは,補強用 梁を残したまま陽極接合によりガラス (HOYA 社製 SD2) 製 の枠に取り付けられ,その後,ピコ秒レーザ・パルスによ り補強用梁を切断し,ミラーが可動するようにした。Fig.4 に陽極接合されたトーション・ミラーの写真を示す。

〈2・3〉 実験装置 完成したトーション・ミラーを球面状に取り付ける取り付け枠は、アルミを機械加工して作製した。各トーション・ミラーに対して中央に孔が開けられた球面の一部に相当する傾斜面がトーション・ミラーの数だけ設けられている。10 cm×10 cmの範囲に 64 個のトーション・ミラーが搭載されたトーション・ミラーアレイ測定部を Fig. 5 に示す。

Glass frame Torsion mirror

Fig. 4. Torsion-mirror with glass frame



Fig. 5. Measurement frame with torsion-mirror array

この時,各トーション・ミラーは Fig.6 に示す断面図の ように,紫外線硬化(UV)樹脂の粘性を利用して,中央に 孔が開けられた球面の一部に相当する傾斜面上で UV 樹脂 の上に浮かべる要領で姿勢制御を行い,ミラー面で反射さ れたレーザ光が PSD の中央に光が当たるような位置で紫外 線照射により固定された。

今回使用したトーション・ミラーの傾き測定用の光学系 は、Fig.1を改良しFig.7に示されるようにトーション・ ミラーをフレネルレンズ状に配置し、凸レンズを更に加え たものである。この凸レンズの直径は、光学スキャナーを 反射して戻ってきた光ビームを通過させればよいので、従 来トーション・ミラーアレイの手前に凸レンズを設けた場 合⁽²⁾に比べ小さくすることができる。

この配置により,トーション・ミラーのアレイはほぼ平 面上に並べることができ薄いアルミ板上に搭載できた。

さらに, Fig. 1(b)では PSD 上のスポットの位置が(1)式に おける f の値として, トーション・ミラーから光スキャナー までの距離であったのに対し, Fig. 7 では小さな直径の凸レ ンズの焦点距離 f を大きくすることにより, 感度の向上を はかることができる⁽³⁾。製作した光学系を Fig. 8 に示す。光 路長を長くした場合に,装置全体が大きくならないよう凸 レンズと PSD の間に 3 個のミラーを置いている。

光スキャナーは1次元 MEMS スキャナーをステッピング モータに搭載し, MEMS スキャナーによる水平スキャンと ステッピングモータを上下に傾けることによる垂直スキャ ンにより2次元の光走査を実現している。



Fig. 6. Setup of torsion-mirror on Al plate



Fig. 7. Optical setup for electrostatic field distribution measurement



Fig. 8. Photograph of optical measurement setup

3. 実験結果

マイクロミラーの厚さが 20µm, 面積が 5mm × 5mm, トーション・バーの厚さが 20µm, 長さが 2mm, 幅が 10µm (実測値は,上のトーション・バーの幅が 8.69µm,下のトー ション・バーの幅が 8.93µm)のトーション・ミラーを使用 し,2次元スキャナーからトーション・ミラーアレイが搭 載されている球面までの長さが 200mmの場合,10mm 離れ た75mm × 40mmの大きさを持つ平板により電圧を印加し た時の中心位置にあるトーション・ミラーによる測定結果 (黒丸)を Fig.9に示す。

図中の実線は理論値を示す。ほぼ,理論値と一致していることが分かる⁽²⁾。また,目標の帯電物質の測定電圧範囲: 100~2kV,測定分解能:10Vは,測定電圧範囲は3kVと広がり高電圧側では測定分解10Vを達成したが,考察で述べるように低電圧領域では誤差が大きくなった。

測定時間の目標1秒以下に関しては、今回、光スキャナー としてステッピングモータに搭載された1次元 MEMS ス キャナーを使用したが、ステッピングモータの角度精度は 十分であったものの回転の移動に時間がかかり1秒以下は 実現できなかった。

また、トーション・ミラーを Fig. 10 に示すように球面上 の中央部の 5 cm × 5 cm に 4 × 4 並べて線状の導体の先に設 けられた 10 mm × 10 mm の平板状の帯電物体を 10 mm の距 離において 2 kV 印加して測定した結果を Fig. 11 に示す。

Fig. 10 において,光ビームの主スキャンが水平方向であ るため,マイクロミラーによる反射ビームがそれとは直角 方向に静電気力で傾き,PSD で反射ビームの上下方向の位 置変化を検出するためにトーション・バーをスキャン方向 と同様に水平になるようにトーション・ミラーが配置され, マイクロミラーの半分の面がシールドプレートにより覆わ れている。Fig. 11 は一点に帯電物体を近づけた場合の各トー ション・ミラーの出力の相対的な傾きを表し,一部(左手 前)のトーション・ミラーの出力が大きな誤差を示してい



Fig. 9. Applied voltage and micro-mirror deflection



Fig. 10. Torsion-mirror array



Fig. 11. Torsion-mirror array output distribution

るが、ほぼ凸状の分布を示している。

各トーション・ミラーの較正がなされていない事が対称 的な分布からのずれを生んでいるとともに,左手前のトー ション・ミラーはトーション・バーが他より細いものが間 違って実装されたため上述のような大きな誤差が発生した ものである。

MEMS マイクロミラーアレイを用いた静電気分布測定装置の空間分解能については、従来の大口径の凸レンズを用いた静電気分布測定系で細い導体をスキャンし求め⁽²⁾半値幅として約4.5mmの値を得ておりIntelliSense社のシミュ

レータ IntelliSuite を用いたシミュレーションでも確かめて いるが、本実験においてもそれから予想される分布とほぼ 等しくなっており、大口径の凸レンズを使用しない本実験 装置が100mm角以上の広い面積の静電気分布測定に適用で きることが分かった。

4. 考 察

今回試作したトーション・ミラーを球面上に配置した光 学系を持つ静電気分布測定装置(Fig.1(b))は、平面上に配 置し凸レンズにより2次元走査された光を並行に照射する 光学系(Fig.1(a))⁽²⁾と比較してほぼ同等の感度とトーショ ン・ミラーアレイのピッチが得られた。すなわち、測定感度 分解能の仕様10Vは高電圧ではほぼ達成できた。しかし、 低電圧では感度が帯電電圧の2乗に比例するため達成でき ていない。また、フルスケールでの誤差は、-4.5~+12%の 範囲で、これは一般的な表面電位計の測定誤差であるフル スケール誤差5%とほぼ同等の値である。また、測定時間の 短縮のためには測定速度を制限している光スキャナーとし て2次元 MEMSミラーの採用を検討している。

これらの結果は等しいトーション・ミラーの傾きに対し, (1), (2)式で示されたように, PSD上での反射光スポット の位置は,それぞれ, PSDと球面との距離,あるいは, PSD と凸レンズとの距離で決定されるため,トーション・ミラー が同じであれば,その距離で決まるためである。

また、トーション・ミラーを分離して搭載するため、同 じ空間分解能を得るためにはマイクロミラーの面積を保っ て全体の面積を小さくする必要があり、Fig.3 に示したよう にマイクロミラーを蝶々型にしてトーション・バーを設け た。その結果、空間分解能は、従来とほぼ同等の値となっ た。左手前のトーション・ミラーは、トーション幅の小さ いものが間違ってつけられており、明らかに誤差の原因に なっており補正が必要であるが、これを除けばほぼ中心が 高い分布が得られた。

トーション・ミラーアレイ及びシールド板はアースされ ており、Fig.1(a)の場合、アースされた導体平面の距離 a だ け離れた位置にある点電荷 + q は、導体平面の面積が十分 大きいとした場合、Fig.12(a)のようにその電気映像として 同じ距離 a の位置に - q の点電荷を発生する。これに対し、 Fig.12(b)の場合、アースされた導体は原点 O、半径 r の球面 であるため、球面から距離 a だけ離れた位置にある点電荷 + q は、球を仮定すると、球面の内側 ra/(r+a)の位置に - rq/ (r+a) の点電荷を発生することが知られている⁽⁴⁾。

今回使用した球面の半径は 20cm であり,帯電物体の位置 は 1cm 離れた位置にあるような測定を行っている。この場 合, a=1cm, r=20cm となり,映像点は ra/(r+a)=0.95 cm, 電荷は -rq/(r+a)=-0.952qで,平面の約 95%の値となり 5% 程度の相違におさまる。

上記の議論のようにトーション・ミラーアレイとシール ドプレートがアースされている場合,帯電物体が正あるい は負の両方の場合とも引力が働きマイクロミラーは同一方



Fig. 12. Charge and image of electrostatic measurement



Fig. 13. Charge detection by control electrode

向に傾くため、そのままでは帯電物体の正負の判定ができない。帯電物体の正負を知るために、新たにシールドプレートの開口部の前面に線状のコントロール電極を設け、コントロール電極に電圧が印加された場合のマイクロミラーの 傾き変化から帯電物体の正負を判断することを試みた。

Fig. 13 はコントロール電極の効果を調べるために直径 0.3 mm の電極をマイクロ・ミラーから 0.5 mm の距離に設けた もので,この電圧を変化させた時にマイクロミラーに働く 力(反射光の傾き)の変化を測定することにより,帯電物 体の極性を知ることの可能性を検討した。測定対象である 帯電物体の極性は,帯電物体の電圧に加えて制御電極に正 または負の電圧を印加した際のマイクロミラーの傾き変化 を測定することにより判定できる。帯電物体の極性と逆の 極性の電圧を制御電極に印加するとマイクロミラーの傾き は減少することは帯電物体からの電気力線の終端がマイク



Fig. 14. Charge detection by control electrode

ロミラーよりも制御電極により集中するためであると解釈 され、また、帯電物体と同じ極性の電圧を制御電極に印加 すると、マイクロミラーの傾きは増加することは制御電極 からの電気力線が加わるためであると考えられる。

この結果はシミュレーションによっても確かめられた。

Fig. 14 は緑色のレーザ光を用いコントロール電極の電圧 を変化した場合のマイクロ・ミラーからの反射光の PSD 上 での位置変化を示したもので,帯電物体の帯電電圧が 2kV において,左図は制御電圧が 0V,右図は制御電圧が-22V の場合である。

図中で最下段の紫色の線上の緑色の反射光パターンは帯 電電圧が 0V の場合に相当し,最上段の紫色の線上の緑色 の反射光パターンは帯電電圧 2kV で制御電圧が 0V の時の, 間の紫色の線上の緑色の反射光パターンは帯電電圧 2kV で 制御電圧が-22V に相当する。これより実際の装置におい て,コントロール電極を設けることにより帯電物体の正負 を検出することが確かめられた。

5. むすび

捻じり梁(トーション・バー)で支えられたマイクロミ ラー(トーション・ミラー)を球面上に2次元状に配置し, マイクロミラーの半面をシールド板で覆うことにより帯電 物体によりトーション・ミラーが傾く。これを2次元光ス キャナーと PSDを用いて,各トーション・ミラーの傾きを 測定する静電気非接触可視化装置を試作した。従来の凸レ ンズを用いた光学系に比べ,ほぼ同様の性能が得られ,今後 広い面積の測定への適用が可能であることが実証された。 また,シールド板近傍に設けられたコントロール電極によ り,帯電物体の帯電の正負を判定することができることが 示された。

謝 辞

本研究は,経済産業省の平成24年度戦略的基盤技術高度 化支援事業「MEMS技術を応用した静電気非接触可視化シ ステムの実用化」として実施された。



 (1) 尾崎 宏:「静電気帯電分布可視化システムの開発」, 鹿児島県工業 技術センター研究成果発表会予稿集, pp.14-15 (2007)

- (2) T. Kuriyama, T. Aoi, H. Maeda, T. Ito, Y. Ueno, T. Nakaie, N. Matsui, and H. Okumura : "MEMS Micro-Mirror Array for Electrostatic Field Distribution Measurement System", *IEEJ Trans. SM*, Vol.130, No.12, pp.575-579 (2010) (in Japanese) 栗山敏秀・青井利一・前田裕司・伊東隆喜・上野吉史・中家利幸・ 松井信近・奥村浩行:「MEMS マイクロミラーアレイによる非接触静 電気分布測定システム」, 電学論 E, Vol.130, No.12, pp.575-579 (2010)
- (3) T. Kuriyama, T. Aoi, H. Maeda, T. Ito, Y. Ueno, T. Nakaie, N. Matsui, and H. Okumura : "Design of Optical System for Electrostatic Field Distribution Measurement Using Micromirror Array", Sensors and Materials, Vol.23, No.7, pp.435-448 (2011)
- (4) 若桑光雄:「電磁気学演習」,昭晃堂, p.128 (1970)



(正員) 1949年2月11日生。1971年3月東京 大学工学部物理工学科卒業。1973年同大修士課 程修了。1977年同大電子工学博士課程修了。同 年日本電気中央研究所入社。1981年から1年間 ペンシルバニア大学客員研究員。2006年近畿大 学教授。現在に至る。半導体レーザ,高耐圧IC, 各種センサ,環境電磁工学の研究に従事。応用 物理学会,電子情報通信学会各会員。



(非会員)1982年大阪府立大学工学部化学工学 科卒業。同年日本ピラー工業(株)勤務。1985 年和歌山県工業技術センター入所。2001年博士 (工学)取得(大阪府立大学)。専門:吸着,排 水処理。



(正員) 1964年12月7日生。1989年3月福井 大学工学部応用物理学科卒業。1991年同大修士 課程修了。1998年同大後期博士課程システム設 計工学修了(工学博士)。1991年京セラ(株) デバイス開発センター勤務。1997年和歌山県工 業技術センター入所。アモルファス薄膜,化合 物半導体デバイス,半導体レーザ励起固体レー ザ,組込みシステム,モデル検査,福祉機器の

研究に従事。日本物理学会,日本応用物理学会,レーザ学会,米国 光学会,日本公衆衛生学会各会員。



(非会員) 1950年4月19日生。1978年3月大阪府立大学大学院工学研究科博士課程修了。 1982年6月和歌山県工業試験場入所。2011年3 月和歌山県工業技術センター電子産業部部長で退職。2011年4月より再任用。自動化・省力 化,画像処理・画像検査などのコンピュータシ ステムの研究開発に従事。



(非会員) 1955年5月12日生。1978年3月大阪工業大学工学部電子工学科卒業。同年,阪和電子工業(株)入社。半導体用静電気破壊試験器など信頼性試験器の開発に従事。現在,高速同期型ノイズシミュレータと静電気可視化装置を開発中。



(非会員) 和歌山生。2004 年,近畿大学電子工 学科卒業。同年阪和電子工業(株)入社。新事 業開発に従事。



 宮本佳明
 (非会員) 2009 年島根大学電子制御工学科卒

 業。同年,阪和電子工業(株)入社。静電気可

 視化装置の開発に従事。